

80A、75V N沟道增强型场效应管

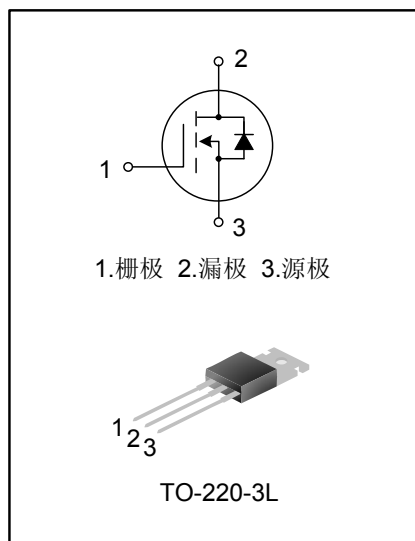
描述

SVD75N08T N 沟道增强型功率 MOS 场效应晶体管，采用士兰微电子新的平面 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。在应用上，优化了器件的寄生参数，增强了栅极抗干扰能力，易于并联使用。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- * 80A, 75V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= $9m\Omega@V_{GS}=10V$
- * 低栅极电荷量
- * 低反向传输电容
- * 开关速度快
- * 提升了 dv/dt 能力



产品规格分类

产 品 名 称	封装形式	打印名称	材料	包装
SVD75N08T	TO-220-3L	SVD75N08T	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}C$)

参 数	符 号	参数范围	单位
漏源电压	V_{DS}	75	V
栅源电压	V_{GS}	± 20	V
漏极电流	I_D	80	A
		70	
漏极脉冲电流	I_{DM}	300.0	A
耗散功率 ($T_C=25^{\circ}C$) - 大于 $25^{\circ}C$ 每摄氏度减少	P_D	300	W
		2.40	W/ $^{\circ}C$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	844	mJ
工作结温范围	T_J	$-55 \sim +150$	$^{\circ}C$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^{\circ}C$

热阻特性

参 数	符 号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.42	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.50	$^{\circ}\text{C/W}$

电性参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	$B_{V_{DS}}$	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	75	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=75V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=40A$	--	9	12	m Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0MHz$	--	3486	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	790	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	143	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=40V, V_{GS}=10V,$ $R_G=25\Omega, I_D=37.5A$ (注 2, 3)	--	55	--	ns
开启上升时间	t_r		--	229	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	260	--	
关断下降时间	t_f		--	124	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=60V, I_D=75A, V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	93	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	20	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	44	--	

源-漏二极管特性参数

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	80	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	300.0	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=80A, V_{GS}=0V$	--	--	1.5	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=80A, V_{GS}=0V,$ $dI/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	91	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	0.33	--	μC

注:

1. $L=0.24mH, I_{AS}=85A, V_{DD}=35V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^{\circ}\text{C}$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图1. 输出特性

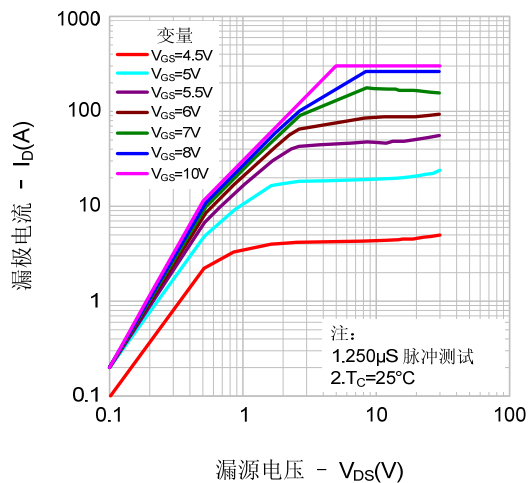


图2. 传输特性

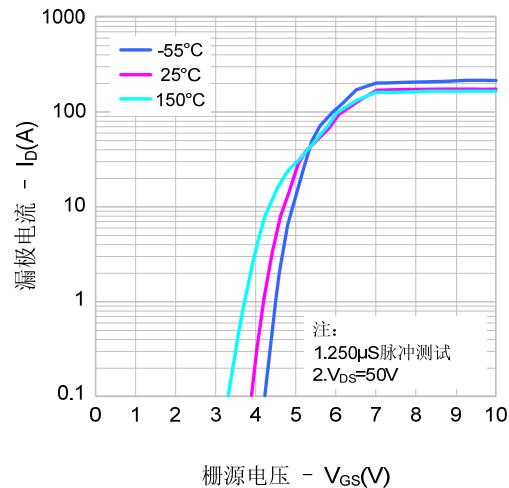


图3. 导通电阻vs.漏极电流

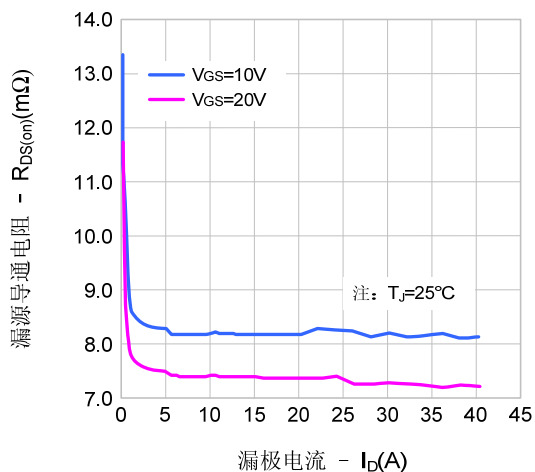


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

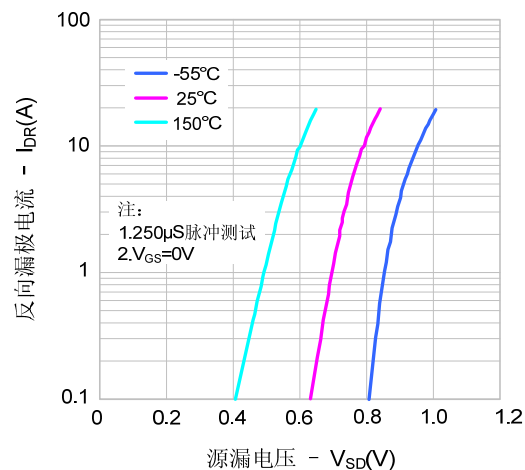


图5. 电容特性

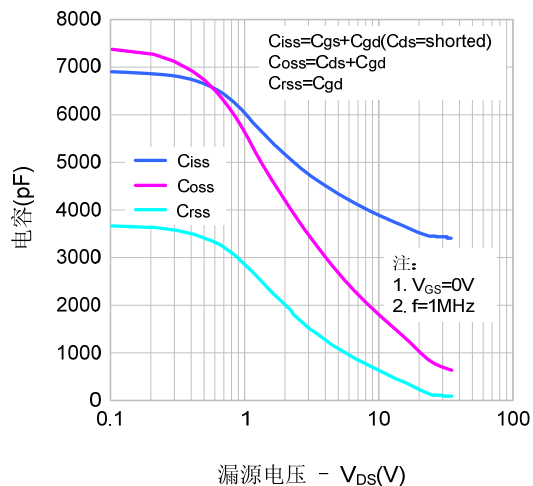
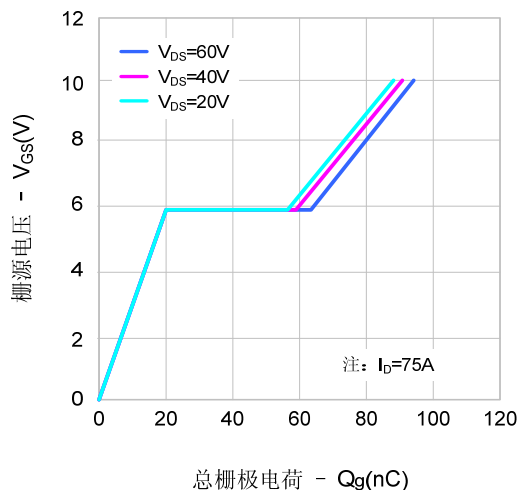


图6. 电荷量特性



典型特性曲线（续）

图7. 击穿电压vs.温度特性

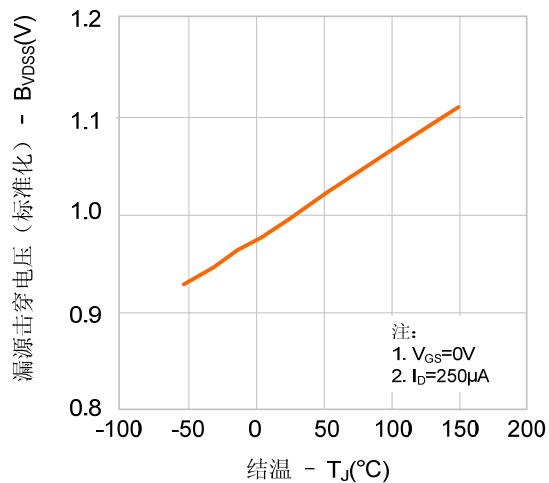


图8. 导通电阻vs.温度特性

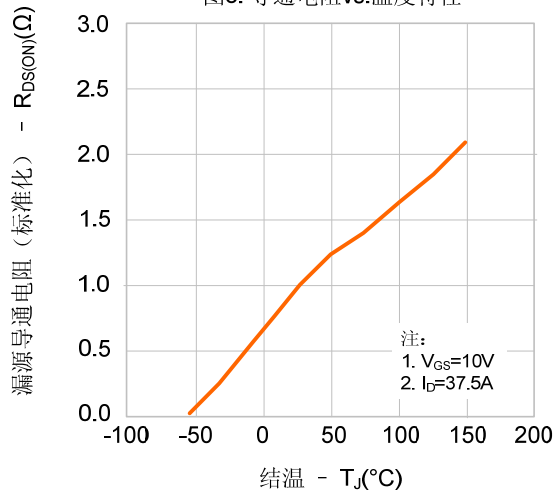
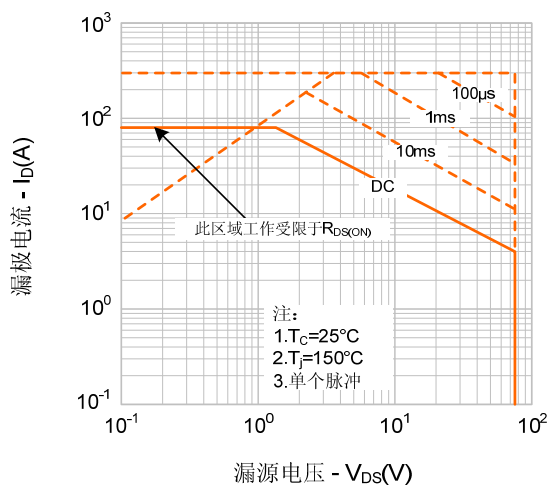
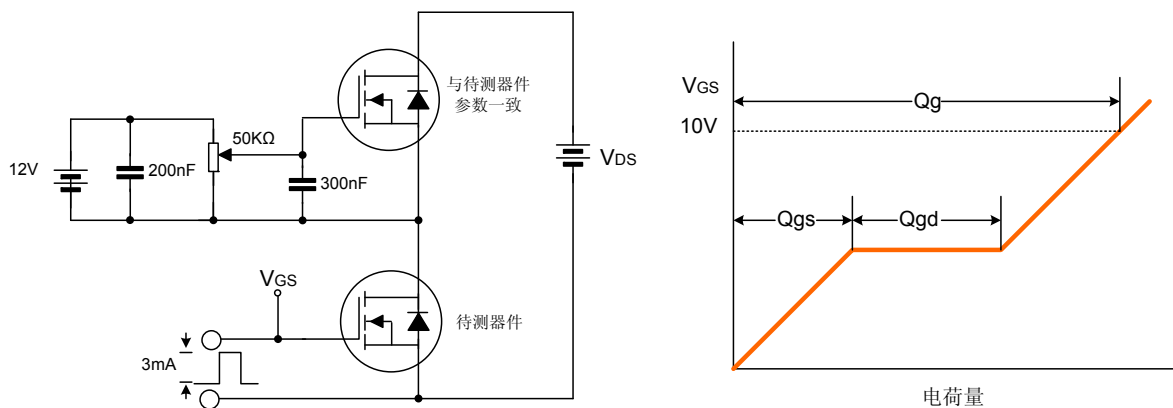


图9. 最大安全工作区域

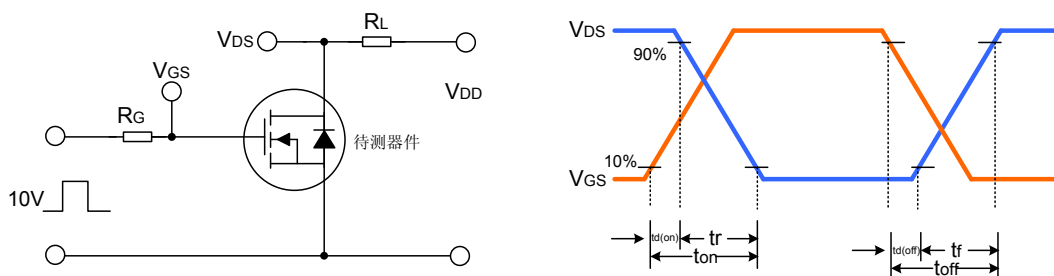


典型测试电路

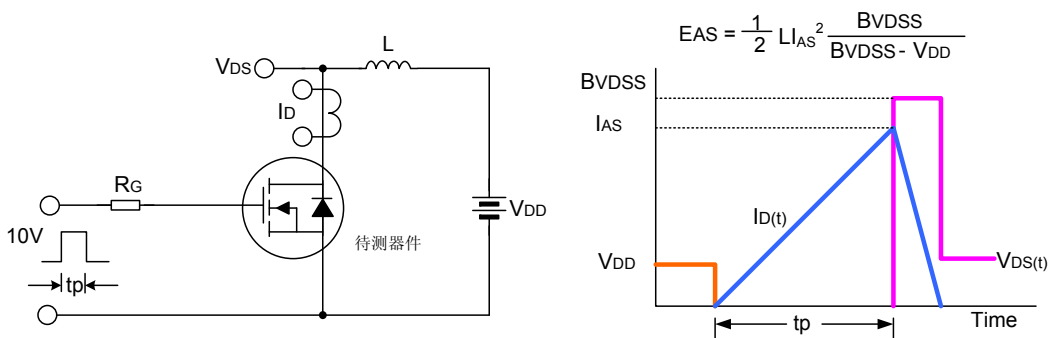
栅极电荷量测试电路及波形图



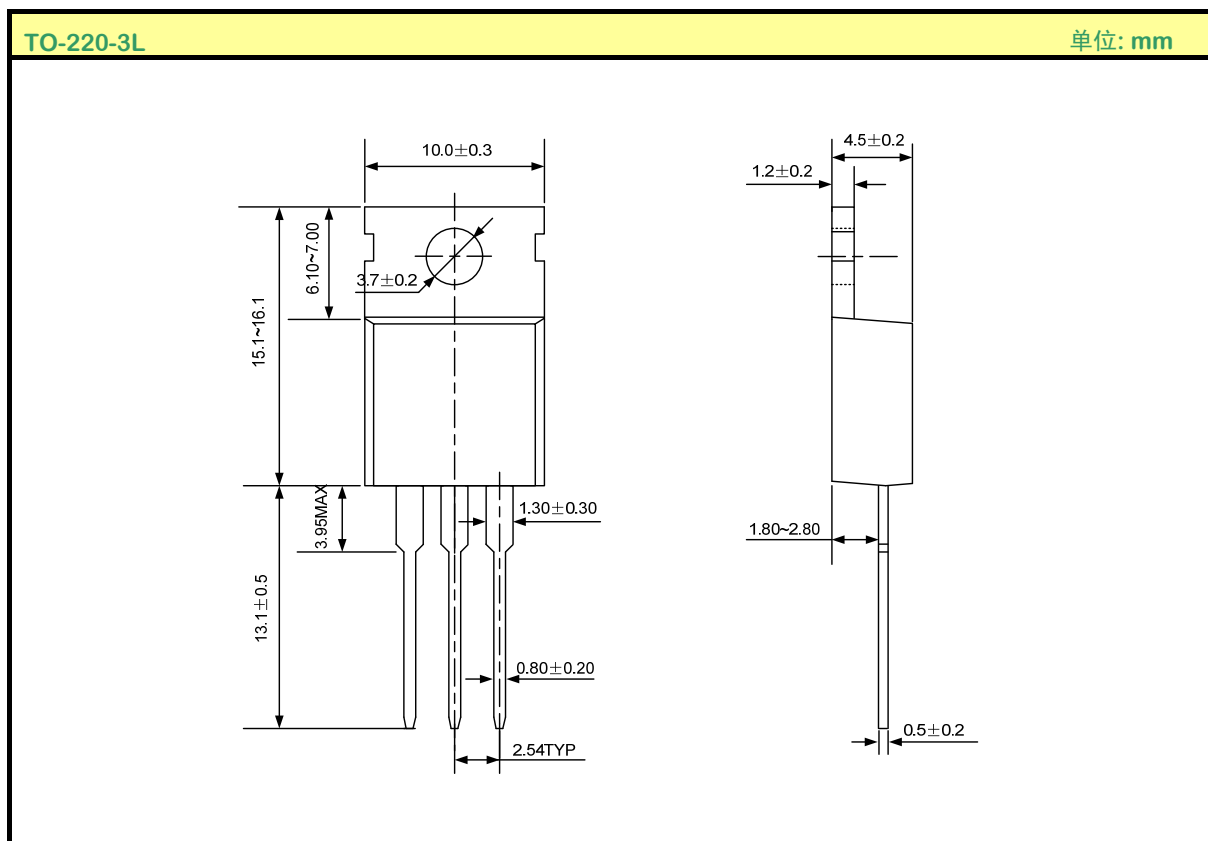
开关时间测试电路及波形图



EAS测试电路及波形图



封装外形图



声明:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

附：

修改记录：

日期	版本号	描 述	页 码
2011.07.15	1.0	原版	
2012.08.23	1.1	修改 “电性参数”	
2012.09.24	1.2	修改 “极限参数”、“热阻特性”、“电性参数”、“典型特性曲线”、“源-漏二极管特性参数”和 “典型特性曲线”	